

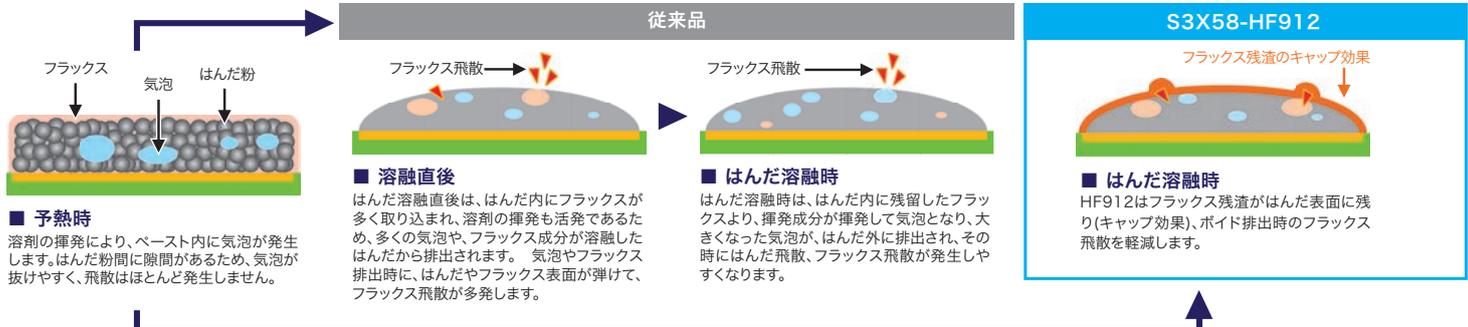


- センサー、コネクタ端子、レンズといった部品箇所へのフラックス飛散の付着を防止します。
- キャップ効果により、リフロープロファイルを選ばずフラックス飛散を低減することができます。
- 濡れ性、ボイド性といった実装品質と、低フラックス飛散性の両立が可能となっています。



表面実装で使用する部品種が増加する中、車載用カメラモジュール、センサー部品においては、実装時にフラックス付着や、高密度実装による実装品質の確保等の課題があります。S3X58-HF912はフラックス飛散防止効果を飛躍的に向上し、実装不良の減少、直行率の向上が実現可能です。

飛散防止メカニズム



フラックス飛散試験

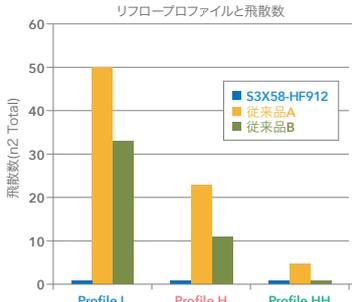
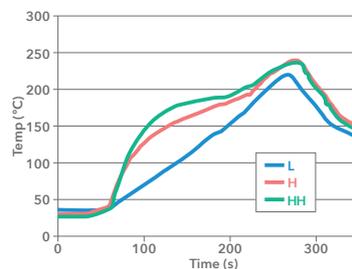
評価方法
 基材: Glass epoxy FR-4
 表面処理: ENIG
 メタルマスク厚: 120 μ m
 評価パターン: 6330Pad部
 加熱方法: エアーリフロー
 雰囲気: 大気
 リフロープロファイル: 右記参照



Profile	Pre-heat Temp.
Profile L	100~200(°C) 95sec
Profile H	150~200(°C) 105sec
Profile HH	150~205(°C) 120sec 180~205(°C) 80sec

	Profile L	Profile H	Profile HH
S3X58-HF912			
従来品 A			
従来品 B			

S3X58-HF912は、従来品では、通常のリフロープロファイルではフラックス飛散が発生しやすく、飛散低減のため予熱温度を高く調整する必要がありますが、当製品では、比較的低温プリヒート条件-Profile L でも飛散の発生を大幅に低減いたしました。



製品名	S3X58-HF912
合金組成 (%)	Sn 3.0Ag 0.5Cu
融点 (°C)	217 - 219
粒径 (μ m)	20 - 38
ハライド含有量 (%)	0
フラックスタイプ	ROLO (IPC J-STD-004A)
フラックス含有量 (%)	11.5
粘度 (Pa.s)	190
シェルフライフ (<10°C)	6 ヶ月